

‘25년 3분기 실적발표



2025.11

Great People Great Technology

Disclaimer

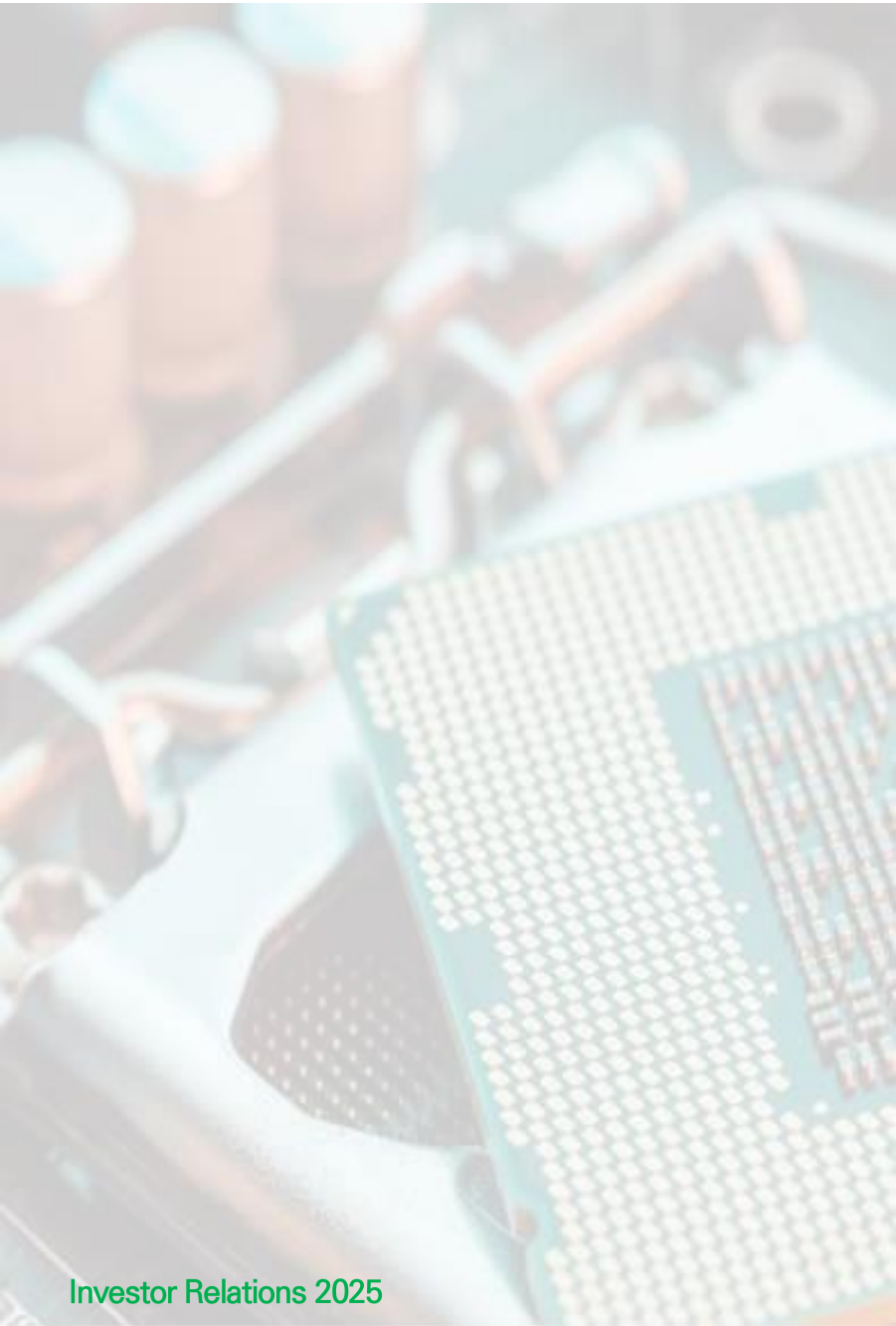
본 자료의 '25년 3분기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적에 대한 추정치이며, 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'를 포함하고 있으며 이러한 '예측정보'에 내재된 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 외부 여건들의 변화와 회사 전략 방향에 따라 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로 사용될 수 없습니다.

Contents

1	'25년 3분기 경영성과
2	향후 사업전망
3	자사주 활용 계획
4	주주친화정책



01

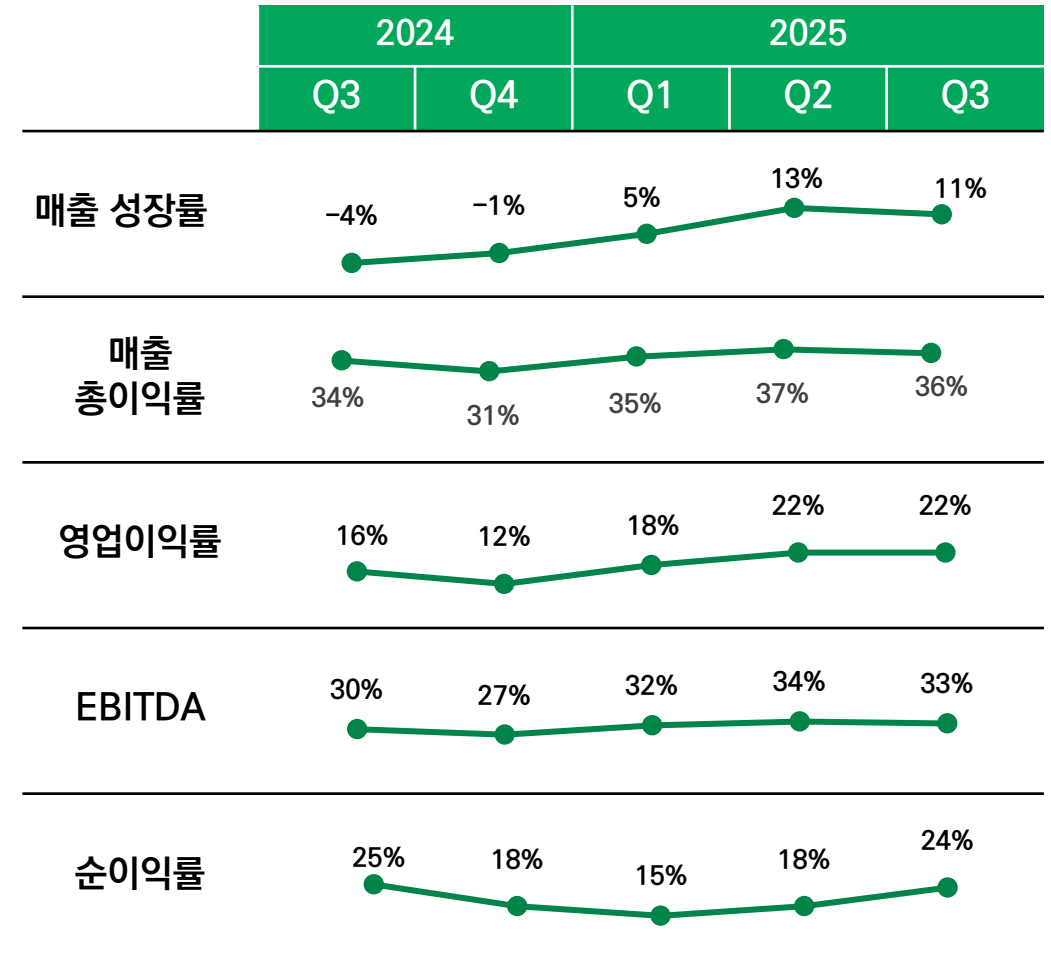
‘25년 3분기 경영성과

'25.Q3 실적_요약

매출 : 3,747억원 (+11% QoQ, +30% YoY), 영업이익 : 806억원 (+9% QoQ, +71% YoY)

매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 30%, 71% 증가, 실적 개선 지속, 다만 자회사인 DB글로벌칩 실적은 악화 (약 81억원 영업적자)

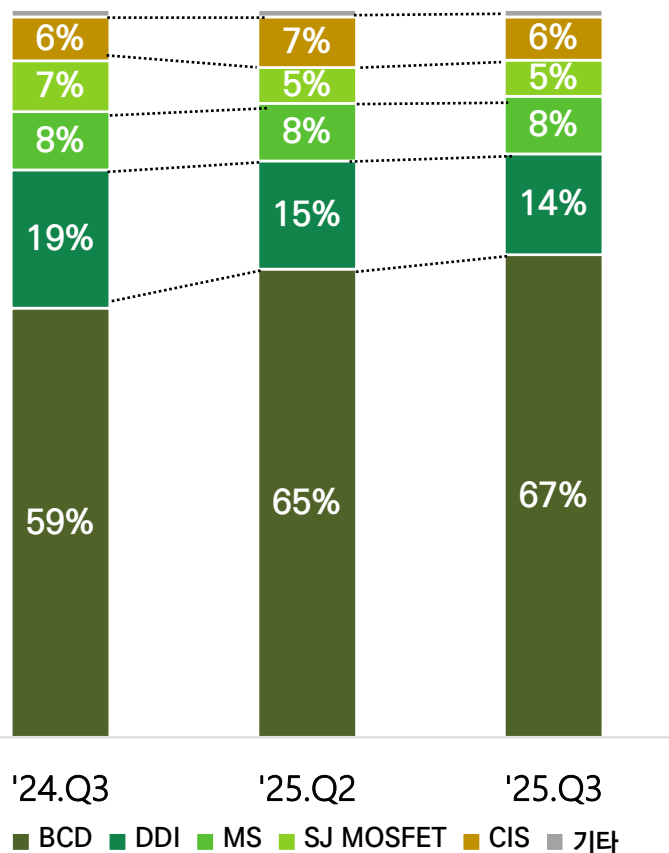
단위 : 억원	2025.Q3	2025.Q2	QoQ	2024.Q3	YoY
매출액	3,747	3,374	+11%	2,878	+30%
- Foundry	3,199	2,987	+7%	2,519	+27%
- Fabless	372	499	-25%	514	-28%
매출총이익	1,360	1,254	+8%	990	+37%
Margin	36%	37%	-1%pt	34%	+2%pt
영업이익	806	738	+9%	471	+71%
Margin	22%	22%	+0.0%pt	16%	+6%pt
EBITDA	1,227	1,148	+7%	868	+41%
Margin	33%	34%	-1%pt	30%	+3%pt
순이익	907	600	+51%	710	+28%
Margin	24%	18%	+6%	25%	-1%pt



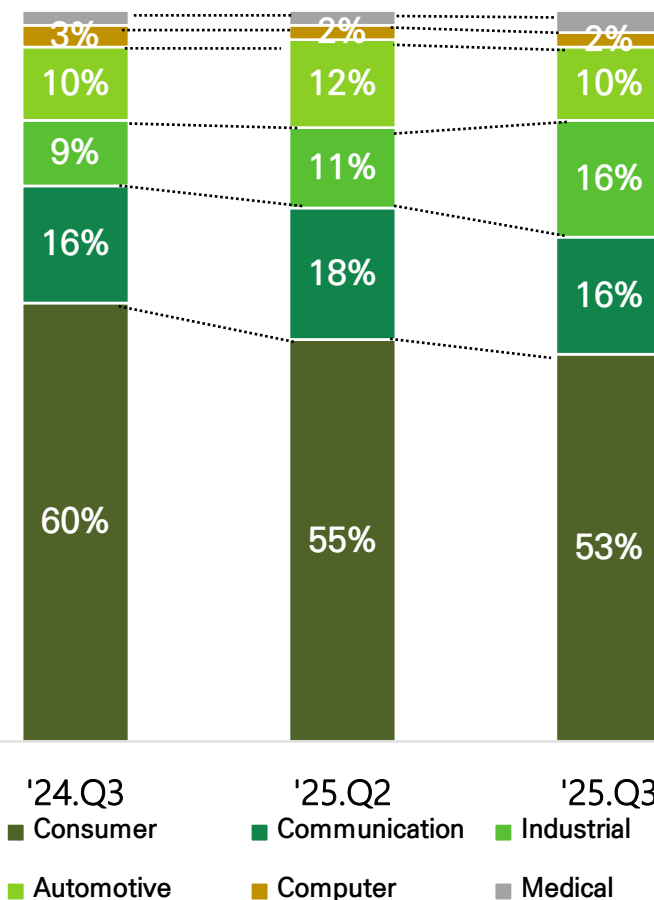
'25.Q3 실적_매출분석

중국 반도체 자국화로 특수 수요 지속, 非중국 지역도 수요 회복
주력제품인 전력반도체 중심 수요 강세 지속, 국내 DDI 부진 영향은 제한적

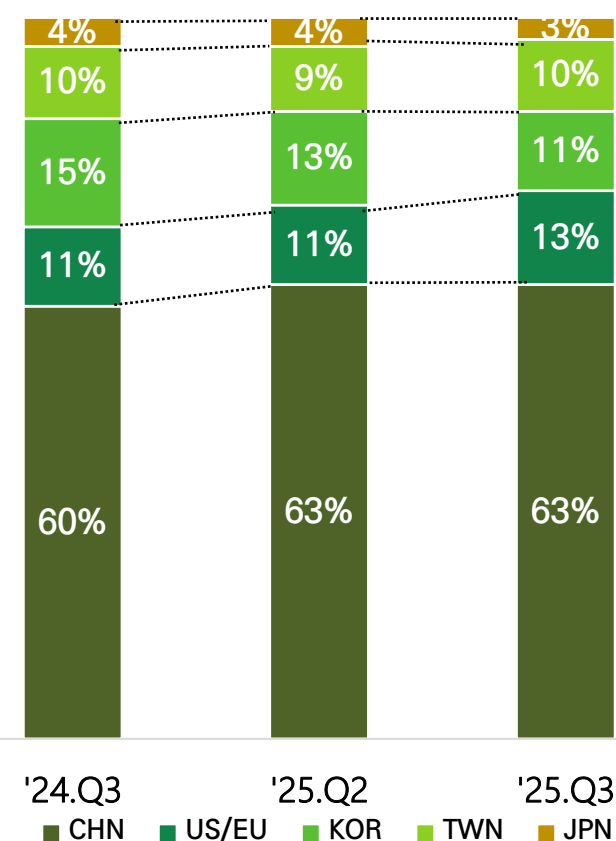
〈제품군별〉



〈응용분야별〉



〈지역별〉





02

향후 사업전망

Foundry

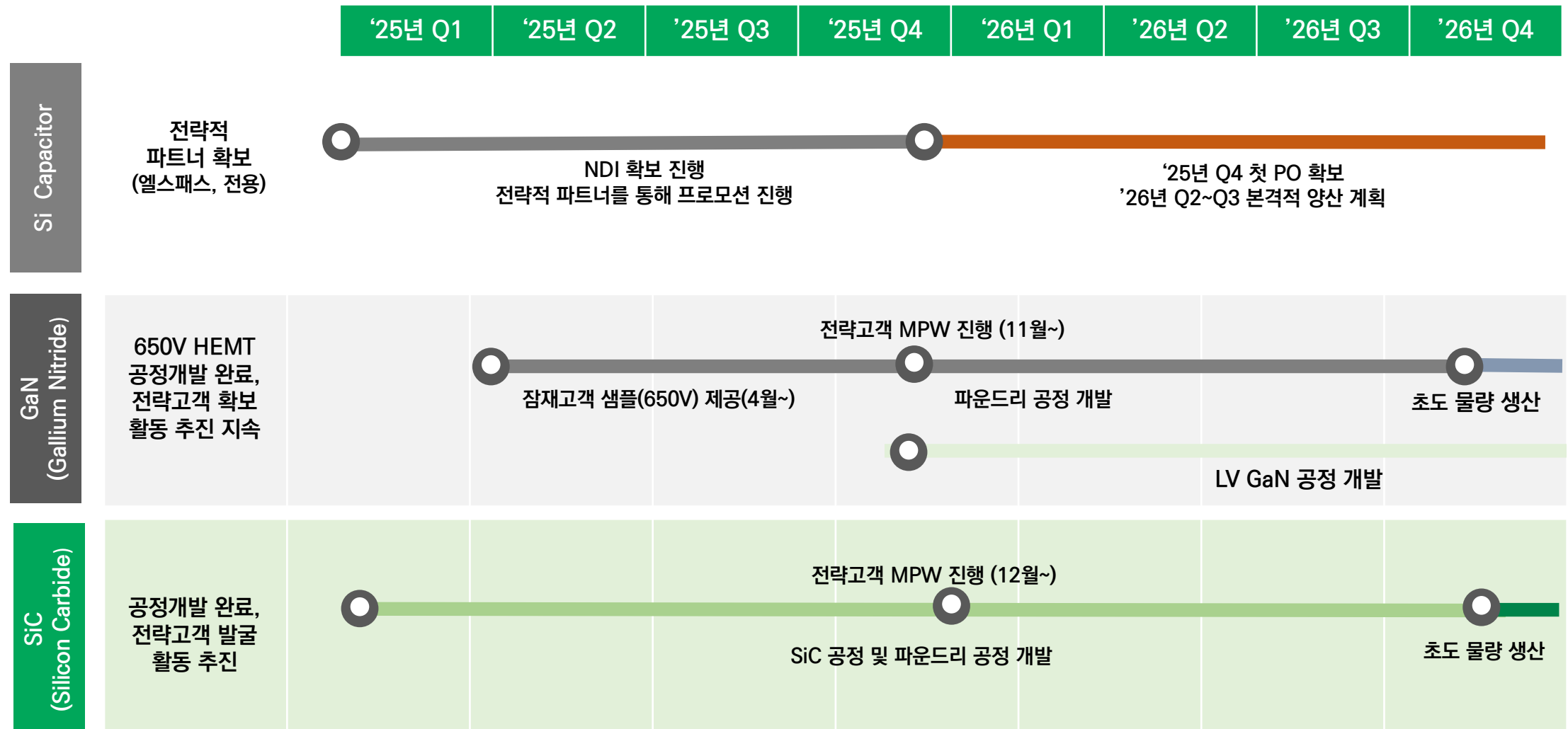
- ✓ 8인치 Foundry :
 - 공급 축소 전망 : TSMC 선단공정 집중, 장기적으로 8인치 1/3 축소 계획, 삼성전자도 일부 축소
 - 시장 가동률 : '25년 Q2 71% → '26년 연간 평균 81.7%로 지속 개선 전망 (출처 : HSBC)
- ✓ Q4 전력반도체 견조한 수요 예상, '25년 연간 가동률 95% 이상 지속 전망
 - '25년 매출(별도) +20% YoY, 영업이익율(별도) 20% 중반 예상
- ✓ 고부가가치 제품 비중 확대와 제품 믹스 변화로 Q4에도 ASP 소폭 상승 전망
 - BCD 제품 투입 증가, DDI/ MOSFET 투입 감소
- ✓ 차세대 전력반도체 사업 도약 위한 기반 구축, 내년 초도 생산 목표로 최종 준비 단계 (신규사업 Roadmap 참고)

Fabless

- ✓ 어려운 시장 환경 속에서도 사업 회복 및 미래 도약 준비
 - 패널사 세트/IT 판매 부진과 수요 약세로 재고 확대, 경쟁 심화되는 시장 환경
 - 중국 반도체 자국화를 극복하기 위해 중국 파운드리 활용 등 전략적 돌파구 모색
 - OLED은 사업 초기단계로 당분간 적자 발생 예상, LCD에서 OLED 중심으로의 체질 전환으로 미래 성장 기반 마련 ('24년 Q2 LCD 매출 비중 74% → '25년 Q3 OLED 매출 비중 71%)

신규사업 Roadmap

※ 위의 신규사업 로드맵은 향후 계획을 설명하기 위한 것이며, 시장 상황 및 내부 사정에 따라 변경되거나 조정될 수 있음



※ 오픈 파운드리 대상 프로모션 품목은 GaN과 SiC이며, 실리콘 캐패시터는 엘스페이스 전용 파운드리 기반 포팅으로 분류됨.

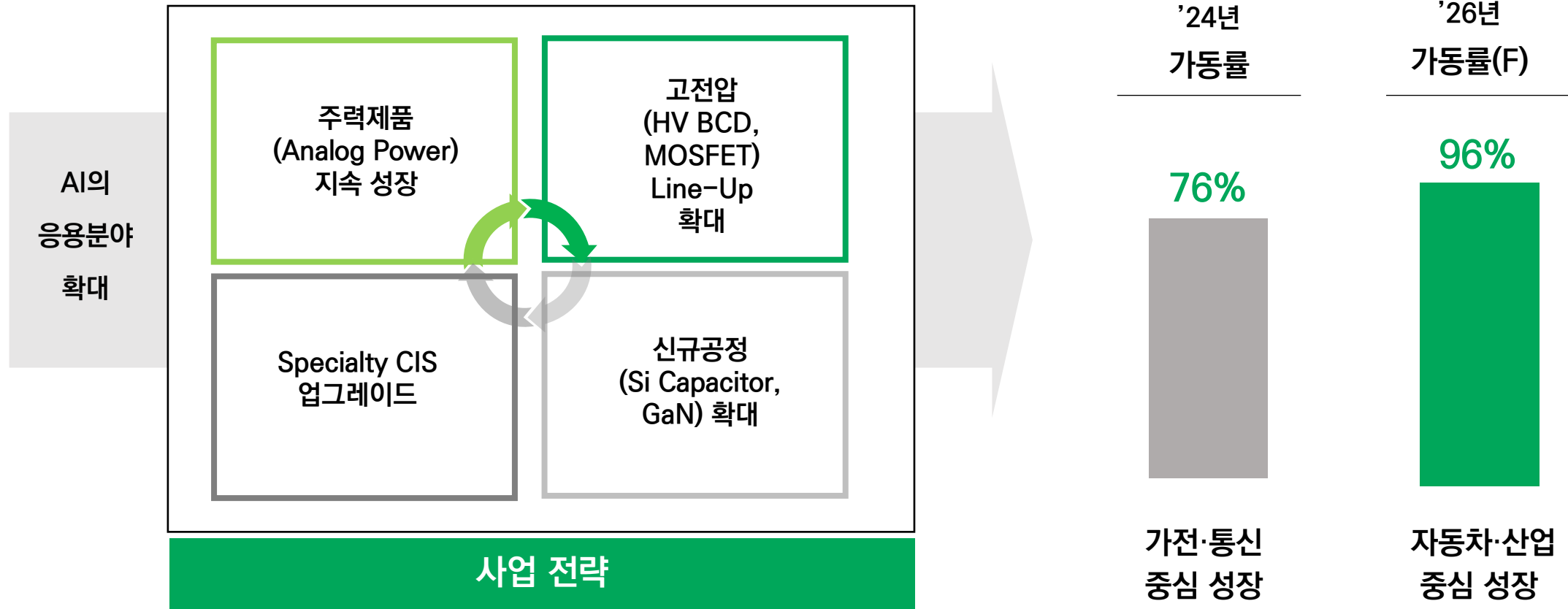
시장 현황

- ✓ TI 가격인상 (1차 6월, 2차 8월)으로 대체 제품 수혜 확대 전망, 시장 재편과 중국 업체 간 경쟁 심화 예상
- ✓ 중국 상무부 반덤핑 조사 개시 공식 발표 ('25.09.13)
 - 조사 기간 '25.9.13~'26.09.13 + 6개월 연장 가능
 - 대상 기업 : TI, ADI, Broadcom, On-Semi 외
 - 최종 판결 : '26년 하반기 ~ '27년 초 예상
- ✓ 정부 주도로 대형 팹리스 중심의 중소형 업체 인수 합병 장려

당사

- ✓ 중국 반도체 자국화 정책으로 당사 고객사 수혜 지속 예상
- ✓ 중국 반덤핑 조사 개시로, 미국 TI 포함 MPS, NXP, ST등 해외 IDM 제품의 중국산 대체 가속화
 - 중국 고객 高전압 전력반도체(자동차, 산업 중심) 수요 강세 지속 전망
 - HV BCD 고객 집중 관리 (자동차 산업향 고객), Q3 투입량은 전년 대비 2배 이상 성장
- ✓ 시장 변화 선제 대응 차원에서 대형 팹리스 영업 강화

'25년 1분기부터 수요 회복, '26년까지 높은 가동률 지속 전망



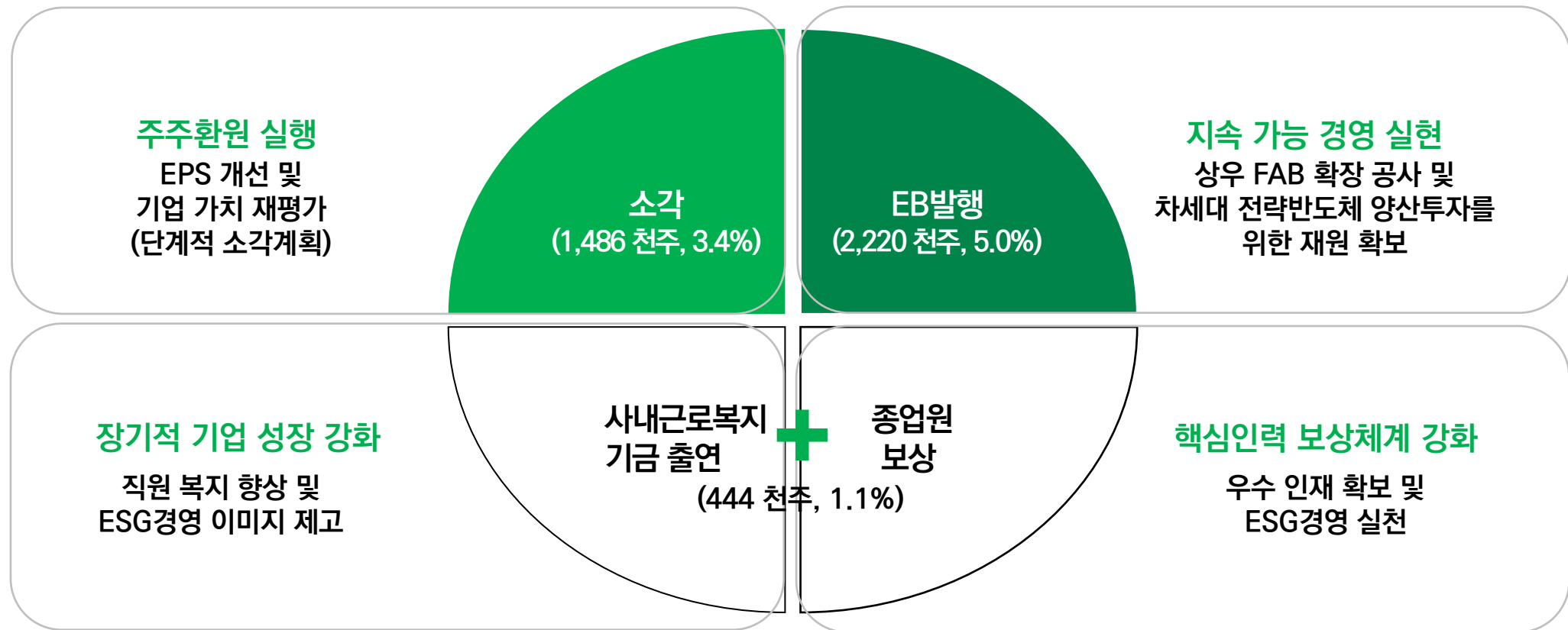
※ Capacitor는 일시적으로 전기를 저장하는 제품 : 배터리가 전류를 흘려 보내도 반도체까지 거리가 있어 전류가 바로 공급 불가, 전류가 도달할 때까지 Capacitor에서 전류를 빠르게 공급



03

자사주 활용 계획

자사주 전략적 활용을 통해 지속가능 경영 강화 및 주주가치 제고



구분	목적	상세
자사주 소각	주주환원 실행	총 소각 예정 주식 수 : 1,486,000주 (3.4%) I. 1차 소각 ('25년) - 소각 주식 수 : 894,000주 - 소각일 : '25년 09.30 II. 2차 소각('26년) - 소각 주식 수 : 592,000주 - 소각 계획 : '26년 중 이사회 결의 후 소각 예정
교환사채 발행	Fab 확장공사 및 차세대 전력반도체 투자를 위한 자원 확보	교환 예정 주식수 : 2,220,000주 (5.0%) - 발행일 : '25.09.23 (5년 만기) - 표면이자율/만기이자율 : 0% - 교환가격 : 56,562원 - 교환청구기간 : '25.10.23 ~ '30.08.23



04

주주친화정책

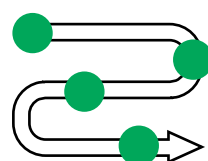
‘24년 주주환원율(A) 30%

중장기 주주친화정책(‘23.12.31 발표) 준수



책임경영 강화

양도제한조건부주식(RSU),
주식보상제도 도입
(‘25년)



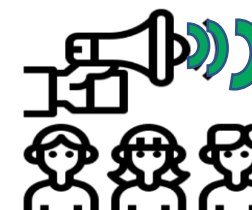
배당절차 개선

주주총회 통한 배당금 규모
先 결정 후 배당 권리 기준일 확정
(‘25년)



IR활동 강화

잠정실적 공시,
분기실적 설명회(‘23년),
해외 IR활동 개시(‘24년 하반기)



영문공시·밸류업·IR자료 제공

전문인력 확보(‘23년)
영문공시, 밸류업공시,
분기실적자료 제공(‘24년)

감사합니다.

IR Contact Info:
hyeyon.park@dbhitek.com